会社法第７８２条第１項に基づく
事前開示書面
（昭和電工光半導体株式会社との会社分割について）

令和２年１１月１７日

昭和電工株式会社

（吸収分割会社）

令和２年１１月１７日

会社法第７８２条第１項に定める吸収分割株式会社の事前開示書面

東京都港区芝大門一丁目 13 番 9 号
昭和電工株式会社
代表取締役社長　森川　宏平

会社法第 782 条第 1 項および会社法施行規則第 183 条の定めに従い、つぎのとおり吸収分割契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。

1.　吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1 項）

資料 1 のとおりです。

2.　分割対価の相当性（会社法施行規則第 183 条第 1 号）

昭和電工光半導体株式会社（以下「吸収分割承継会社」といいます。）は、昭和電工株式会社（以下「吸収分割会社」といいます。）に対して分割対価として自己の株式 100 株を交付します。

吸収分割承継会社は吸収分割会社の完全子会社であり、交付される株式数によって吸収分割会社は影響を受けないことから、吸収分割承継会社と吸収分割会社との協議により決定しました。

3.　吸収分割承継会社および吸収分割会社についての事項（会社法施行規則第 183 条第 4 号、5 号）

（１）吸収分割承継会社

①会社成立の日における計算書類等の内容

資料２のとおり。

②会社成立の日以後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは当該臨時計算書類等の内容

該当事項なし。

③会社成立の日以後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重大な影響を与える事象が生じたときは、その内容

該当事項なし。

（２）吸収分割会社

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重大な影響を与える事象が生じたときは、その内容

第 112 期第 1 四半期報告書の（重要な後発事象）および第 112 期第 2 四半期報告書の（企業結合等関係）に記載の通り、吸収分割会社の完全子会社である HC ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、日立化成株式会社（2020 年 10 月 1 日付で商号を昭和電工マテリアルズ株式会社に変更しております。以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法による公開買付（以下「本公開買付け」といいます。）によって 2020 年 4 月 28 日に下記のとおり取得し、その結果、対象者は吸収分割会社の連結子会社（孫会社）となりました。なお、公開買付者は、本公開買付により、対象者の普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除く。）を取得できなかったことから、対象者は、公開買付者からの要請に基づき、2020 年 6 月 23 日を効力発

生日として株式併合（以下、「本件株式併合」といいます。）を実施しました。本件株式併合により、公開買付者以外の株主の所有する普通株式は、1株に満たない端数となり、その端数株式については、会社法第235条第2項の準用する第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、119,470百万円で2020年10月15日付で公開買付者が取得しております。なお、当該端数株式の取得に係る資金に充当することを目的として、公開買付者は、2020年10月9日に、㈱みずほ銀行より119,000百万円を借り入れております。

本公開買付の概要、本公開買付を含めた対象者を公開買付者の完全子会社とするための取引に係る資金の調達方法および本件株式併合の内容は以下のとおりです。

(1) 公開買付けの概要

①対象者の名称、事業内容及び規模

名称 日立化成株式会社

事業内容 機能材料（電子材料、配線板材料、電子部品）、

先端部品・システム（モビリティ部材、蓄電デバイス・システム、ライフサイエンス）

資本金 155億円

②公開買付けの期間

2020年3月24日（火曜日）から2020年4月20日（月曜日）まで（20営業日）

③株式取得日

2020年4月28日（火曜日）

④取得価額

844,569百万円

⑤取得した議決権比率

本公開買付け実施前の議決権比率 －%

本公開買付け実施後の議決権比率 87.61%

（注）本公開買付け実施後の議決権比率は、対象者が2020年2月12日に提出した第71期第3四半期報告書に記載された2019年12月31日現在の発行済株式総数（208,364,913株）から、対象者が2020年1月28日に公表した「2020年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）」に記載された2019年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数(146,683株)を控除した株式数（208,218,230株）に係る議決権の数（2,082,182個）を分母として計算している。また、本公開買付け実施後の議決権比率は、小数点以下第三位を四捨五入している。

(2) 支払資金の調達

吸収分割会社及び公開買付者は、本公開買付けを含めた対象者を公開買付者の完全子会社とするための取引に係る資金に充当することを目的に、公開買付者が株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」という。）より借入れを行う（概要は下記「①ノンリコースローン契約の概要」を参照。）とともに、公開買付者においてみずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行（以下「日本政策投資銀行」という。）を引受先とするA種優先株式の発行（概要は下記「②優先株式発行の概要」を参照。）並びに吸収分割会社を引受先とする普通株式の発行（概要は下記「③普通株式発行の概要」を参照。）を行うことを決定し、下記概要に記載のとおり実行されました。

また、吸収分割会社は、吸収分割会社による公開買付者の発行する普通株式の引受けに必要となる資金を調達することを目的として、みずほ銀行より借入れを行うこと（概要は下記「④シニアローン契約の概要」を参照。）を決定し、下記概要に記載のとおり実行されまし

た。

①ノンリコースローン契約の概要

	タームローンA	タームローンB	コミットメントライン
(1) 借入人	公開買付者		
(2) 貸付人	みずほ銀行		
(3) 借入金額	500億	3,500億	900億
(4) 金利	全銀協日本円TIBORに基づく変動金利		
(5) 弁済方法	分割弁済	期限一括弁済	期限一括弁済
(6) 実行日	2020年4月27日		
(7) 最終弁済期日	2025年4月27日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、翌営業日が翌月となる場合には、その直前の営業日とする。）		個別貸付実行から1週間～6ヵ月後
(8) 担保	日立化成株式等		

②優先株式発行の概要

(1) 発行会社	公開買付者
(2) 発行株式数	2,750億株
(3) 発行価額	1株につき1円
(4) 引受人	みずほ銀行 1,850億株 日本政策投資銀行 900億株
(5) 払込金額（総額）	2,750億円
(6) 払込期日	2020年4月27日
(7) 取得条項	払込期日の5年後の応当日以降、金銭を対価として取得可能
(8) 資本性	「中・50%」（株式会社日本格付研究所）
(9) その他	議決権を有しない

（注）公開買付者が取得条項を行使することにより本優先株式を取得する場合、又は当社が本優先株式を買い取る場合、本優先株式と同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た手段により資金を調達することを意図している。ただし、一定の財務指標を満たす場合にはリプレイスメントを見送ることができる。

③普通株式発行の概要

(1) 発行会社	公開買付者
(2) 発行株式数	2,950億株
(3) 発行価額	1株につき1円
(4) 引受人	当社
(5) 払込金額	2,950億円
(6) 払込期日	2020年4月27日

④シニアローン契約の概要

(1) 借入人	当社
(2) 貸付人	みずほ銀行
(3) 借入金額	2,950 億円
(4) 金利	全銀協日本円 TIBOR に基づく変動金利
(5) 弁済方法	期限一括弁済
(6) 実行日	2020 年 4 月 27 日
(7) 最終弁済期日	2027 年 4 月 27 日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、翌営業日が翌月となる場合には、その直前の営業日とする。）

(3) 株式併合の内容

(ア) 併合する株式の種類

普通株式

(イ) 併合比率

対象者株式 26,027,000 株を 1 株に併合する。

(ウ) 減少する発行済株式総数

208,364,905 株

(エ) 効力発生前における発行済株式総数

208,364,913 株

(オ) 効力発生後における発行済株式総数

8 株

(カ) 効力発生日における発行可能株式総数

32 株

(キ) 1 株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額

株式併合の結果生じる 1 株未満の端数については、その合計数（合計数に 1 株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられる。）に相当する数の株式を売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付する。当該売却について、対象者は、会社法第 235 条第 2 項の準用する同法第 234 条第 2 項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却し、又は会社法第 235 条第 2 項の準用する同法第 234 条第 4 項の規定に基づき、裁判所の許可を得て対象者が買い取る。この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、株主の皆様の所有する対象者株式の数に本公開買付価格と同額である 4,630 円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような価格に設定する。

4. 吸収分割が効力を生じる日以後における吸収分割会社の債務および吸収分割承継会社の債務（吸収分割会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る）の履行の見込に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6 号）

吸収分割会社は、本件分割の効力発生日以後における吸収分割会社の債務および吸収分割承継会社の債務（吸収分割会社が本件分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限ります。）の履行の見込に関し、次の通り判断します。

（１）吸収分割会社

吸収分割会社の令和２年６月 30 日現在の連結貸借対照表における資産および負債の額はそれぞれ 2,106,297 百万円および 1,378,795 百万円であり、資産の額が負債の額を上回っております。なお、本件分割により吸収分割会社が吸収分割承継会社に承継させる予定の資産および負債の令和２年６月 30 日現在における帳簿価額は、それぞれ 1,744 百万円、0 円です。

吸収分割会社においては、令和２年６月 30 日以後本日までの間、債務の履行に支障を及ぼすような大幅な減収、多額の損失の発生等は生じておらず、効力発生日まで吸収分割会社の資産および負債の額が変動することも予想されますが、これらの変動を考慮しても効力発生日において吸収分割会社の資産が負債の額を上回ることが見込まれています。

さらに、効力発生日以後において、吸収分割会社の債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は、現在のところ予想されておりません。

以上から、効力発生日以後における吸収分割会社について、債務の履行の見込みがあるものと判断します。

（２）吸収分割承継会社

吸収分割承継会社は令和２年 10 月９日に設立され、設立時の貸借対照表における資産の額は１円、負債はなく、本件分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継する予定の資産および負債の令和２年６月 30 日現在における帳簿価額は、それぞれ 1,744 百万円および 0 円であり、いずれも資産の額が負債の額を上回っています。

吸収分割承継会社においては、令和２年 10 月９日の設立以後本日までの間、債務の履行に支障を及ぼすような大幅な減収、多額の損失の発生等は生じておらず、効力発生日までに吸収分割承継会社の資産および負債の額が変動することも予想されますが、これらの変動を考慮しても効力発生日において吸収分割承継会社の資産が負債を上回ることが見込まれています。

さらに、効力発生日後において、吸収分割承継会社の債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は、現在のところ予想されておりません。

以上から、効力発生日以後における吸収分割承継会社について、債務の履行の見込みがあるものと判断します。

なお、会社法施行規則第 183 条第２号および第３号については該当事項はありません。

以上



吸収分割契約

昭和電工光半導体株式会社（以下、「甲」という。）と昭和電工株式会社（以下、「乙」という。）は、以下のとおり吸収分割契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

第１条 （目的）

1. 乙は、本契約の定めるところに従って、吸収分割（以下、「本件分割」という。）の方法により、乙が営む対象事業（次項において定義する。）に関する権利義務を、甲に対して承継させ、甲はこれを承継する。
2. 乙が甲に対して承継する対象事業とは、乙が営んでいる光半導体事業およびレアアース磁石合金事業（以下、あわせて「対象事業」という。）をいうものとする。

第２条 （商号・住所）

本件分割に係る吸収分割承継会社および吸収分割会社の商号および住所は、次のとおりである。

吸収分割承継会社
商号：昭和電工光半導体株式会社
住所：埼玉県秩父市下影森 1505 番地

吸収分割会社
商号：昭和電工株式会社
住所：東京都港区芝大門一丁目 13 番 9 号

第３条 （承継する権利義務）

1. 本件分割により甲が乙から承継する権利義務は、次の各号に掲げるものとし、その詳細については甲乙合意により定めるものとする。但し、法令、条例、行政指導、契約上の合意等の理由により承継ができない場合には、承継する権利義務に該当しないものとする。
   （１） 効力発生日（第 4 条において定義する。以下同じ。）において乙が対象事業のために有する別紙１記載の資産、負債
   （２） 効力発生日において乙が対象事業のために締結している別紙２記載の契約上の地位
   （３） 効力発生日において乙が対象事業のために有する別紙３記載の知的財産権
   （４） 効力発生日において乙が対象事業のために有する別紙４記載の許認可等
2. 前項にしたがって甲が乙から承継する債務については、免責的債務引受とする。
3. 会社法第 759 条第 2 項または第 3 項により甲および乙の連帯債務となった債務がある

ときは、当該債務は、本条第1項に従って甲が承継することとされた債務については甲がこれを負担するものとし、それ以外の債務については乙がこれを負担するものとする。

4. 甲は、本件分割に際し、乙の事業に従事する従業員との雇用契約を一切承継しない。乙の従業員の取扱いについては、別途、甲および乙が定めるところによるものとする。

第4条 （効力発生日）

本件分割がその効力を生ずる日（以下、「効力発生日」という。）は、2021年1月1日とする。但し、本件分割手続の進行に応じ、必要あるときは、甲乙協議の上これを変更することができる。

第5条 （分割に際して交付する金銭等）

甲は、本件分割に際して、普通株式100株を発行し、その全部を乙に割当交付する。

第6条 （甲の資本金および準備金）

本件分割により増加すべき甲の資本金および準備金の額は、次のとおりとする。

（1） 資本金　　金99,999,999円
（2） 資本準備金　　金900,000,000円
（3） 利益準備金　　金0円

第7条 （分割承認総会）

1. 甲は、効力発生日の前日までに株主総会を開催し、または会社法第319条に基づく書面決議によって、本契約の承認その他本件分割に必要な事項に関する決議を求めるものとする。
2. 乙は、会社法第784条第2項の規定により、株主総会の承認を得ないで本件分割を行う。

第8条 （競業避止義務の免除）

乙は、本件分割の効力発生後においても、甲に対して、会社法第21条第1項に定める競業避止義務を負わないものとする。

第9条 （会社財産についての善管注意義務）

甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、善良な管理者の注意義務をもって、各自の業務を遂行し、自己の資産、債務、権利または義務に重大な影響を及ぼす事項については、事前に甲乙協議を行った上でのみ、実行するものとする。

第１０条（分割条件の変更および本契約の解除）

本契約締結の日から効力発生日までの間に、天災地変その他の事由により、甲または乙のいずれかの財産状態もしくは経営状態に重大な変動が生じたとき、または本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じたときは、甲および乙は、相互に協議の上、本件分割の条件を変更し、または本契約を解除することができる。

第１１条（失効）

本契約は、法令に基づき要求される監督官庁等の承認等または第 7 条第 1 項に定める株主総会の承認を得られないときは、その効力を失う。

第１２条（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本件分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上これを定める。

本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ捺印の上、各 1 通を保有する。

2020 年 11 月 6 日

埼玉県秩父市下影森 1505 番地
甲　昭和電工光半導体株式会社
代表取締役　臼田　雅彦

東京都港区芝大門一丁目１３番９号
乙　昭和電工株式会社
代表取締役　森川　宏平

別紙１　　承継する資産・負債

以下の 2020 年 12 月 31 日時点（以下「基準日」という。）の資産および負債を基礎とし、基準日以降本件分割の効力発生日までの対象事業における通常の業務過程で生じる変動を反映したもの。

１．固定資産

（１）機械装置等

効力発生日において乙が対象事業に供するために所有する機械装置、車輌運搬具、工具器具備品及び構築物

（２）建設仮勘定

効力発生日において乙が対象事業に供するために所有する機械装置等に関して計上している建設仮勘定

（３）無形固定資産

効力発生日において乙が対象事業に供するために所有するソフトウェア、システム

（４）有価証券等

効力発生日において乙が所有する昭光エレクトロニクス株式会社の株式全て（普通株式 1,800 株）

２．流動資産

棚卸資産

効力発生日において乙が対象事業のために所有する製品、半製品、原材料および貯蔵品

３．債務

債務は、一切承継しない。

別紙２　　承継する契約上の地位

効力発生日における対象事業に係る以下に記載する契約の契約上の地位を基礎とする。なお、適用範囲が対象事業以外の事業にも及ぶ契約の乙の契約上の地位は承継しない。また、効力発生日において既に乙に発生している契約上の権利および義務ならびに当該効力発生日以前の原因に基づき当該効力発生日以降に発生する契約上の権利および義務は承継しない。

（１）営業取引に関する契約
（２）資材取引に関する契約
（３）共同出願契約、特許実施許諾契約等の知的財産権関連契約
（４）製造委託契約、業務委託契約等の請負契約
（５）その他、対象事業のために必要となる一切の契約

別紙３　承継する知的財産権

効力発生日までに対象事業のために乙が登録しまたは出願（共同出願を含む。）した知的財産権で、かつ法令上承継可能なもの。

別紙４　承継する許認可等

対象事業に関する許可、認可、免許、登録、届出等のうち、法令等上承継可能なもの。

以上





昭和電工光半導体株式会社

貸借対照表

令和2年10月9日現在

単位：円

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産	1	流動負債	0
現預金	1	固定負債	0
固定資産	0	負債合計	0
		（純資産の部）	1
		株主資本	
		資本金	1
		資本合計	1
資産合計	1	負債及び資本合計	1